# Карты идентификационные

# КАРТЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ БЕСКОНТАКТНЫЕ

Часть 2

Размеры и расположение зон связи

Издание официальное

## ГОСТ Р ИСО/МЭК 10536-2-2004

### Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии», Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ), ОАО «Московский комитет по науке и технологиям»

ВНЕСЕН ТК 22 «Информационные технологии»

- 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 98-ст
- 3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта ИСО/МЭК 10536-2:1995 «Карты идентификационные. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) бесконтактные. Часть 2. Размеры и расположение зон связи»
  - 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### Карты идентификационные

#### КАРТЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ БЕСКОНТАКТНЫЕ

## Часть 2

## Размеры и расположение зон связи

Identification eards, Contactless integrated circuit(s) cards, Part 2. Dimensions and location of coupling areas

**Дата введения 2005-01-01** 

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает размеры, расположение, принцип действия и назначение каждой из зон связи, которые должны быть предусмотрены у бесконтактных карт на интегральных схемах (CICC) формата ID-1 по ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810 и терминального оборудования (ССD) с сопрягающими пазом или поверхностью.

Стандарт не устанавливает:

- размеры, расположение и назначение элементов связи на СІСС;
- размеры, расположение и назначение элементов связи на ССD;
- средства генерирования полей связи.

Настоящий стандарт следует применять совместно с ИСО/МЭК 10536-1.

В приложении А представлен способ определения осей X и Y для СІСС, используемых для установления зон локализации полей.

В приложении Б представлены примеры элементов связи как в CICC, так и в CCD.

Размеры, указанные в настоящем стандарте, являются номинальными и выражены в миллиметрах; рисунки выполнены без соблюдения масштаба.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810—2002 Карты идентификационные. Физические характеристики ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-2—2002 Информационная технология. Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 2. Размеры и расположение контактов

ИСО/МЭК 10536-1:2000\* Карты идентификационные. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) бесконтактные. Карты поверхностного действия. Часть 1. Физические характеристики

ИСО/МЭК 10536-3:1996\* Карты идентификационные. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) бесконтактные. Часть 3. Электронные сигналы и процедуры восстановления

## 3 Определения, сокращения и обозначения

#### 3.1 Определения

В настоящем стандарте используют термины и определения по ИСО/МЭК 10536-1, а также следующие.

3.1.1 зона индуктивной связи: Зона, через которую проходит магнитный поток заданной плотности, положительно способствующий запуску элемента связи.

Международные стандарты ИСО/МЭК — во ВНИИКИ Госстандарта России.

## ГОСТ Р ИСО/МЭК 10536-2-2004

3.1.2 зона емкостной связи: Зона, через которую может осуществляться емкостная связь между СІСС и ССD.

#### 3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применяют следующие сокращения.

- 3.2.1 СІСС бесконтактная карта на интегральной(ых) схеме(ах) (contactless integrated circuit(s) card) по ИСО/МЭК 10536-1.
  - 3.2.2 ССD терминальное оборудование (card coupling device) по ИСО/МЭК 10536-1.

#### 3.3 Обозначения

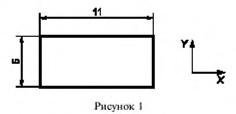
В настоящем стандарте применяют следующие обозначения.

- 3.3.1 1D-1 по ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810.
- 3.3.2 X по приложению A.
- 3.3.3 Y по приложению А.

# 4 Размеры зон связи

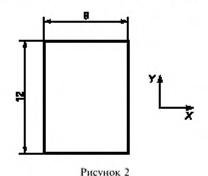
#### 4.1 Зоны индуктивной связи

Каждая зона должна иметь размеры в соответствии с рисунком 1,



#### 4.2 Зоны емкостной связи

Каждая зона должна иметь размеры в соответствии с рисунком 2.



# 5 Число и расположение зон связи

Настоящий стандарт определяет восемь зон связи. Четыре из них являются зонами индуктивной связи и обозначаются H1—H4; размеры для них указаны на рисунках 1 и 3. Четыре других являются зонами емкостной связи и обозначаются E1—E4; размеры для них указаны на рисунках 2 и 4.

СІСС не должна использовать все указанные зоны связи. Для ССD следует предусмотреть возможности для использования всех указанных зон связи. Использование зон связи определено в ИСО/МЭК 10536-3.

# 5.1 Расположение зон индуктивной связи

Расположение центров четырех зон индуктивной связи показано на рисунке 3.

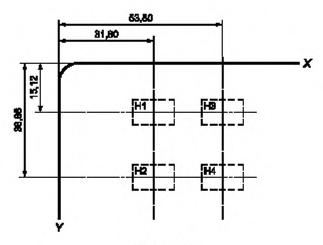


Рисунок 3

## 5.2 Расположение зон емкостной связи

Расположение центров четырех зон емкостной связи показано на рисунке 4.

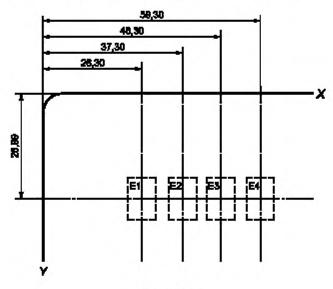


Рисунок 4

## ПРИЛОЖЕНИЕ A (справочное)

## Определение осей Х и У

Настоящее приложение содержит описание способа определения осей для СІСС, используемых для установления зон локализации полей.

Строят две взаимно перпендикулярные оси X и Y, пересекающиеся в точке 0. Отмечают три контрольные точки: на оси X — точки P2 и P3 на расстоянии 11,25 мм и 71,25 мм, соответственно, от точки 0; на оси Y — точку P1 на расстоянии 27 мм от точки 0. Карту располагают таким образом, чтобы ее верхняя кромка касалась точек P2 и P3, а левая кромка — точки P1 (см. рисунок P3).

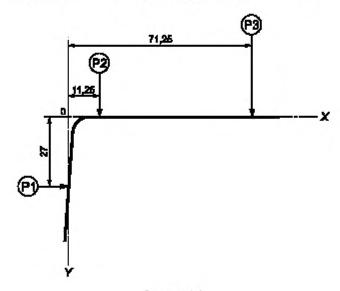
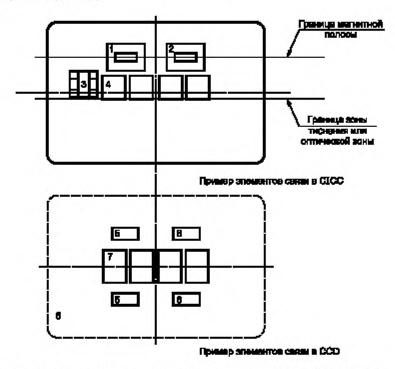


Рисунок А.1

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)

## Примеры элементов связи в СІСС и ССО

На рисунках Б.1 и Б.2 показаны примеры элементов связи и вариантов их компоновки. Элемент связи — это физическая структура в СІСС или ССD, которая генерирует или воспринимает электрическое или магнитное поле.



I — индуктивный элемент I; 2 — индуктивный элемент 2; 3 — контакты по ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-2, 4 — емкостные элементы СІСС; 5 — индуктивный элемент с U-образным сердечником I; 6 — индуктивный элемент с U-образным сердечником 2; 7 — емкостные элементы ССО; 8 — контур СІСС, размещенной в ССО. СІСС, располагаемая внутри этого контура, может быть ориентирована четырьмя возможными способами

Примечания

- Этот пример не запрещает использование больших индуктивных элементов для дистанционной связи.
- 2 СІСС не должна иметь всех показанных элементов связи.

Рисунок Б.1 — Пример элементов связи в СІСС и ССD

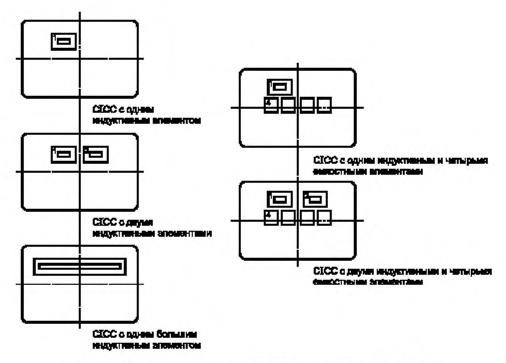


Рисунок Б.2 — Примеры вариантов компоновки элементов связи в CICC

УДК 336.77:002.006.354 ОКС 35.240.40 Э46 ОКП 40 8470

Ключевые слова: обработка данных, обмен информацией, банковское дело, методы идентификации, идентификационные карты, IC-карты, технические требования, размеры, расположение

Редактор В.П. Огурцов Технический редактор О.Н. Взасова Корректор Р.А. Ментова Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Изд. лиц. № 02354 от 14.07,2000. Сдано в набор 30.03.2004. Подписано в печать 12.04.2004. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,60. Тираж 152 экз. С 1750. Зак. 417.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14. http://www.standards.ru e-mail: info@standards.ru Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6. Плр № 080102